

第10世代 インテル® Core™ プロセッサ / Xeon® W搭載可能 2.5GbE×3、PoE+×4、USB3.2 (Gen2)×6、COM×4装備

ECX-2025R

- 第10世代 インテル® Core™ プロセッサ / インテル® Xeon® W プロセッサを搭載可能
- インテル® W480E チップセット装備
- PoE+ポート(IEEE 802.3at)×4基装備
- 2.5GbEポート×3基、1GbEポート×2基装備
- USB3.2ポート(Gen2)×6基装備
- COMポート×4基装備
- 9V~50V DC-in
- 16 DIO(8 DI, 8 DO)搭載可能 ※オプション
- 2.5"リムーバブルディスク×2基搭載可能
- 最大-40℃~+70℃の広温度対応 ※35W TDP CPU搭載時
- 長期供給と安定稼働に優れたEmbedded構成



ファンレスで耐環境性能に優れた設計

最大-40℃~+70℃の広温度範囲に対応し、また筐体がファンレス構造によりチリやホコリが多くて厳しい過酷な環境下でも安定性動作を可能にします。

最大10コア20スレッドCPU搭載でマルチタスク処理の向上

第10世代 インテル® Core™ プロセッサのi9-10900E/i9-10900TE、インテル® Xeon® W プロセッサのW-1290E/W-1290TEは10コア20スレッドのプロセッサ。マルチタスクを高速に処理することが可能です。

LAN & PoEの各ポートはそれぞれ独立したコントローラを装備

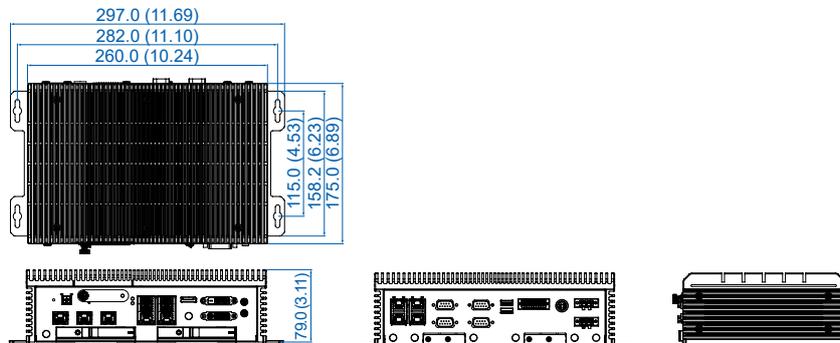
ECX-2025Rには、1GbEポート×2基、2.5GbEポート×3基、PoE+ポート×4基のEthernetを装備しています。各ポートには独立したコントローラを搭載することで帯域遅延を低減させシームレスなデータ転送を実現しています。ネットワークをはじめ、GbEカメラやPoEカメラ、その他デバイスを同時に多数接続することを可能にします。

※画像はイメージです

■製品仕様

製品名		ECX-2025R	
プロセッサ	種類	第10世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー インテル® Xeon® W プロセッサ・ファミリー	
	搭載数	1	
チップセット		インテル® W480E チップセット	
メモリー	規格	DDR4 2933MHz	
	容量	64GB	
	スロット数	2	
ストレージ	2.5" SSD/HDD	2 (フロントアクセス)	
	MicroSD	1	
	M.2	1 (Key M ソケット、2280、PCI-Express x4)	
SIM カードソケット		2 (nanoSIM用)	
グラフィックス		インテル® UHD グラフィックス 630	
I/O	シリアル (COM)	4 (RS-232/422/485)	
	USB	6 (USB3.2、Gen2)	
	DIO	絶縁型16 (8 DI、8 DO)	
	DisplayPort	1 (最大4096 × 2304 @ 60Hz)	
	DVI-I	1 (最大1920 × 1200 @ 60Hz)	
	DVI-D	1 (最大1920 × 1200 @ 60Hz)	
	Ethernet (1GbE)	LAN 1 : インテル® I219LM GigE LAN、iAMT 14.0 LAN 2 : インテル® I210 GigE LAN	
	Ethernet (2.5GbE)	LAN 3 : インテル® I225 2.5GigE LAN 4 : インテル® I225 2.5GigE LAN 5 : インテル® I225 2.5GigE	
	PoE	LAN 6 : GigE IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+、インテル® I210 LAN 7 : GigE IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+、インテル® I210 LAN 8 : GigE IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+、インテル® I210 LAN 9 : GigE IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+、インテル® I210	
	拡張スロット	Mini PCI-Express	Mini PCIe (PCIe/USB/SIM Card/Optional mSATA用)×1
		M.2	1 (Key E ソケット、2230) 1 (Key B ソケット、3042/3052)
オーディオ	コーデック	Realtek ALC888S, 7.1 Channel HD Audio	
	端子	1 Mic-in, 1 Line-out	
電源	入力電圧	9V~50V、DC-in	
	ACアダプター	オプション 160W ACアダプター (PSE認証、24V、85V AC~264V AC、-30°C~+70°C対応) 180W ACアダプター (PSE認証、24V、90V AC~132V AC / 180V AC~264V AC、0°C~+40°C対応) 280W ACアダプター (PSE認証、24V、85V AC~264V AC、-30°C~+70°C対応) *ACアダプターは3-pin Terminal Blockを使用します。	
	電源入力タイプ	3-pin Terminal Block : V+, V-, Frame Ground 4-pin Mini-DIN	
	イグニッションコントロール	16 Mode (ソフトウェアイグニッションコントロール)	
	リモートスイッチ	3-pin Terminal Block	
	サージ保護	過渡電圧:最大80V/1ms	
外観寸法 (W × L × H)		260.0mm x 175.0mm x 79.0mm (突起物等を除く)	
重量		約3.8kg	
取付方法		ウォールマウント用ブラケット、DINレールマウント (オプション)、2Uラックマウント (オプション)	
利用環境	動作温度	35W TDP CPU : -40°C~+75°C、Fan非動作時	
		65W TDP CPU : -40°C~+55°C、Fan非動作時	
		80W & 95W TDP CPU : -40°C~+55°C、Fan動作時	
	保存温度	-40°C~+85°C	
	湿度	5%~95% RH (結露なきこと)	
	耐衝撃性	IEC 60068-2-27	
	耐振動性	SSD : 50G @ wallmount, Half-sine, 11ms	
		IEC 60068-2-64	
EMC指令	SSD : 5Grms, 5Hz to 500Hz, 3 Axis CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2		

■I/Oポート/ 寸法 単位:mm(inch)



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
営業時間:9:00~18:00(土日、祝日、年末年始を除く)

TEL:03-5446-5535 mail:cto_sales@hpc.co.jp

WEBサイト:https://embe.hpc.co.jp/

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices,Incの商標です。Microsoft、Windows は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

2021年8月現在の内容です。

第11世代 インテル® Core™ プロセッサ搭載 コンパクトな筐体で最大-40℃~+75℃の広温度範囲に対応

SPC-7100

- 第11世代インテル® Core™ プロセッサ搭載(SoC)
- 150.4mm×106.2mm×57.0mmでコンパクトなファンレス筐体
- 最大-40℃~+75℃の広温度範囲に対応
- USB3.1×2基、USB2.0×2基装備
- COMポート×2基装備
- 9V~55V DC-in
- 最大-40℃~+75℃の広温度対応
- 長期供給と安定稼働に優れたEmbedded構成



コンパクトで耐環境性能に優れた設計

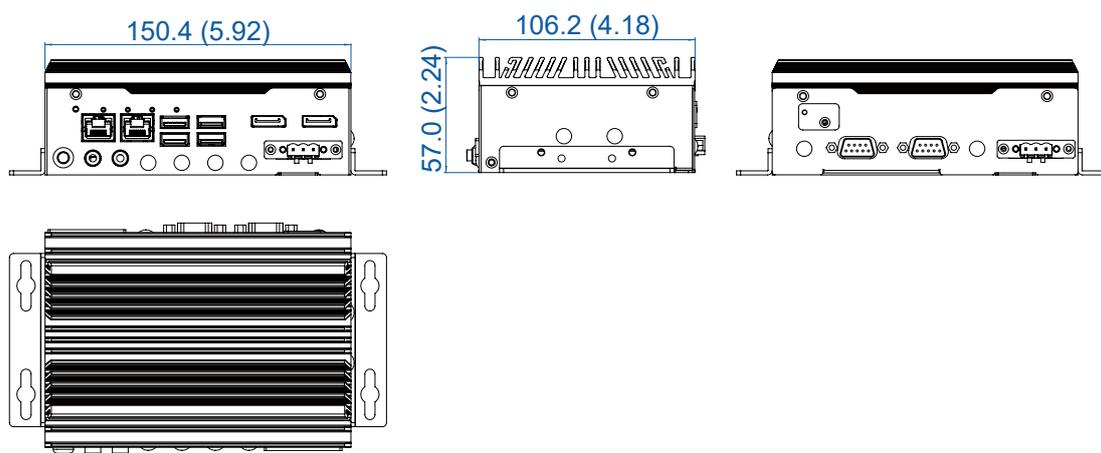
150.4mm × 106.2mm × 57.0mmとコンパクトなファンレス筐体。最大-40℃~+75℃の広温度範囲に対応し、またチリやホコリが多くて厳しい過酷な環境下でも安定性動作を可能にします。

※画像はイメージです

■製品仕様

製品名	SPC-7100	
プロセッサ	種類	第11世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー
	搭載数	1
チップセット	SoC	
メモリー	規格	DDR4 3200MHz SO-DIMM
	容量	最大32GB
	スロット数	1
ストレージ	2.5" SSD	1 (内部)
	M.2	1 (Key B 2260ソケット)
SIM カードソケット	1 (Nano SIM用)	
グラフィックス	インテル® Iris® Xe グラフィックス	
I/O	シリアル (COM)	2 (RS-232/422/485)
	USB	2 (USB3.1)、2 (USB2.0)
	DisplayPort	2 (最大4096 × 2304 @ 60Hz)
	Ethernet (1GbE)	LAN 1 : インテル® I219LM GigE LAN、iAMT LAN 2 : インテル® I225-IT、2.5GigE
拡張スロット	M.2	1 (Key B、3042/3052)、1 (Key E、2230)
オーディオ	コーデック	Realtek ALC892, 5.1 Channel HD Audio
	端子	1 Mic-in, 1 Line-out
電源	入力電圧	9V~55V、DC-in
	ACアダプター	オプション 120W ACアダプター (PSE認証、24V、90V AC~264V AC) ※ACアダプターは3-pin Terminal Blockを使用します。※ACアダプターは0℃~+40℃対応。
	電源入力タイプ	3-pin Terminal Block:V+,V-, Frame Ground
	イグニッションコントロール	16 Mode (内部)
	リモートスイッチ	3-pin Terminal Block
外観寸法 (W × L × H)	150.4mm x 106.2mm x 57.0mm (突起物等を除く)	
重量	約1.3kg	
取付方法	ウォールマウント用ブラケット、DINレールマウント (オプション)、VESAマウント (オプション)	
利用環境	動作温度	-40℃~+75℃
	保存温度	-40℃~+85℃
	湿度	5%~95% RH (結露なきこと)
	耐衝撃性	IEC 60068-2-27 SSD:50G @ wallmount, Half-sine, 11ms
	耐振動性	IEC 60068-2-64、SSD搭載時5Grms, 5Hz~500Hz, 3 Axis
	EMC指令	CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2

■I/Oポート/ 寸法 単位:mm(inch)



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
営業時間:9:00~18:00(土日、祝日、年末年始を除く)

TEL:03-5446-5535 mail:cto_sales@hpc.co.jp

WEBサイト:https://embe.hpc.co.jp/

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。

2021年8月現在の内容です。

第10世代Core™ プロセッサとQ470Eチップセット を搭載。ハイエンドGPU搭載可能な奥行き389mm

画像処理・マシンビジョン向け 産業用PC
IPC-C470SCQ-MT

- 第10世代インテル® Core™ プロセッサ搭載
- インテル® Q470Eチップセット装備
- USB3.2(Gen2)を計4基装備
- 組み込みに適したコンパクトサイズ
- ハイエンドGPUボードが搭載可能
- 信頼性の高いニプロン電源を搭載
- 長期供給と安定稼働に優れたEmbedded構成



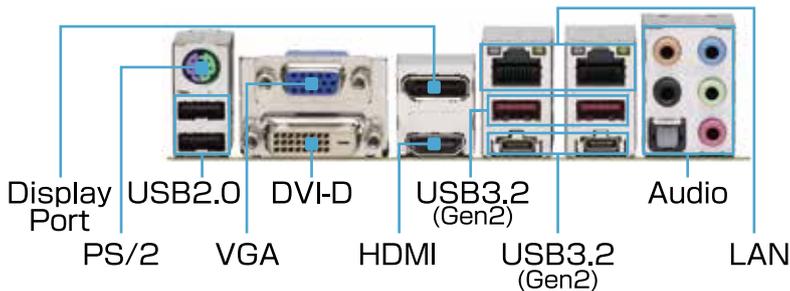
長期安定供給を可能にするインテル® Q470Eチップセット

生産品質と効率向上を加速させ、長期安定供給を可能にするインテル® Q470Eチップセットと第10世代インテル® Core™プロセッサを搭載。マルチタスク処理の向上に適したハイパフォーマンス産業用コンピュータを実現。

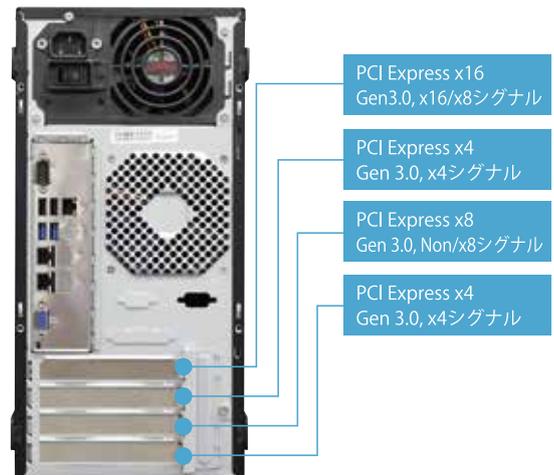
■製品仕様

モデル		IPC-C470SCQ-MT	IPC-C470SCQ-MT 短納期可能モデル
プロセッサ	種類	第10世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー ※TDP最大65Wまでのインテル® Core™ i9 / Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® プロセッサをサポート	第10世代インテル® Core™ プロセッサ i9-10900E (10コア20スレッド、2.80 GHz、TDP65W) i7-10700E (8コア16スレッド、2.90 GHz、TDP65W)
	搭載数	1	
チップセット		インテル® Q470Eチップセット	
メモリー	規格	DDR4-2933 nECC	
	容量	標準16GB (8GB×2) ※最大128GB (32GB×4)	32GB (16GB×2)
	スロット数	4	
ストレージ	5インチベイ	2	480GB SSD ×1
	3.5インチベイ	1	
	3.5インチシャドールベイ	1	
ODD		-	Super Multi DVD
グラフィックス		インテル® UHD グラフィックス	
I/O	PS/2	1 (KB/Mouse)	
	HDMI	1	
	DisplayPort	1	
	DVI-D	1	
	VGA	1	
	USB	前面 2 (USB2.0, TypeA) / 背面 2 (USB3.2, Gen2, TypeA)、2 (USB3.2, Gen2, TypeC)、2 (USB2.0, TypeA)	
	COM	2	
	LAN	2 (GbE)	
	Audio	6 (SPDIF-out, Surround-out, CEN/LFE-out, Mic-In, Line-in, Line-out)	
拡張スロット		Slot4 : PCI-Express x16 (Gen 3.0、x16/x8シグナル、CPU側) Slot3 : PCI-Express x4 (Gen 3.0、4シグナル、PCH側) Slot2 : PCI-Express x8 (Gen 3.0、Non/x8シグナル、CPU側) Slot1 : PCI-Express x4 (Gen 3.0、4シグナル、PCH側)	
OS		Windows10 IoT Enterprise LTSC 2019 64-bit (日本語/英語) Windows 10 Pro 64bit (日本語/英語)	
外形寸法		ミニタワー W170mm × D389mm × H350mm (突起物等を除く)	
重量		約8.5kg	
電源		ニプロン電源 400W (連続最大容量)/570W (ピーク容量)	
利用環境	入力電圧	AC90V~240V	
	温度	10℃~35℃	
	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)	
保管環境	温度	-10℃~55℃	
	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)	

■I/Oポート



■拡張スロット



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
営業時間:9:00~18:00(土日、祝日、年末年始を除く)

TEL:03-5446-5535 mail:cto_sales@hpc.co.jp
WEBサイト:https://embe.hpc.co.jp/

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。

2022年2月現在の内容です。

Xeon® W / 第10世代Core™ プロセッサ搭載 レガシーPCI拡張スロット、USB 3.2 (Gen2)と2.5GbEを装備

画像処理・マシンビジョン向けタワー型 産業用PC
IPC-W480SAE-T

- インテル® Xeon® W プロセッサ / 第10世代インテル® Core™ プロセッサ搭載
- インテル® W480チップセット装備
- マルチギガビットイーサネット(2.5GbE)を装備
- USB3.2(Gen2)を計4基(Type-A、Type-C)装備
- レガシーPCI拡張スロットを装備
- 信頼性の高いニプロン電源を搭載



ハイエンドGPUを搭載可能

NVIDIA® Ampere アーキテクチャーの NVIDIA RTX シリーズ / GeForce RTX 30 シリーズを搭載可能。GPU メモリーによる高速処理が求められるマシンビジョン、ディープラーニング、エッジコンピューティング分野などに適しています。

※ GPU を搭載する場合、標準搭載している電源から変更が必要になります。

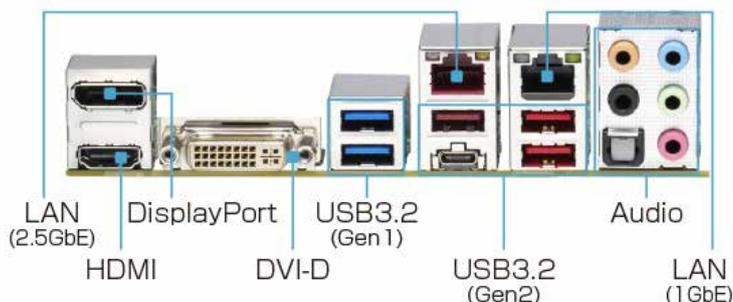
マルチギガビットイーサネット(2.5GbE)を装備

マルチギガビットイーサネット (2.5GbE) は、既設の 1Gbps (カテゴリー 5e/6) LAN ケーブルをそのまま使用し、1Gbps から 2.5G/5Gbps へ速度を上げられる技術。データ量が大きく高解像度画像などを扱うマシンビジョン・画像処理分野において、高速伝送を実現します。

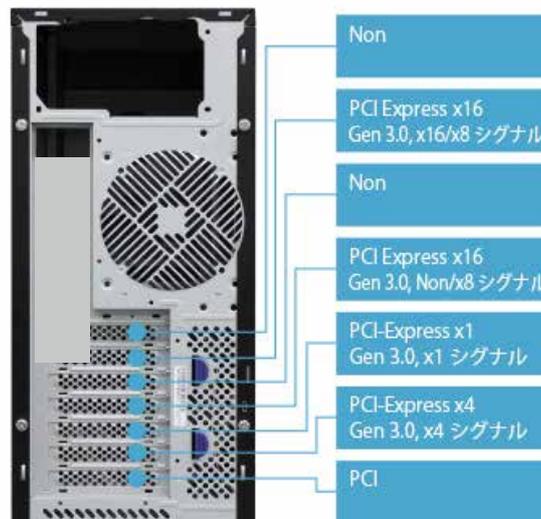
■製品仕様

モデル		IPC-W480SAE-T	IPC-W480SAE-T 短納期可能モデル
プロセッサ	種類	第10世代インテル® Core™ プロセッサ インテル® Xeon® Wプロセッサ	インテル® Xeon® W-1290E (10コア20スレッド、3.50 GHz、TDP95W)
	搭載数	1	
チップセット		インテル® W480 チップセット	
OS		-	
メモリー	規格	DDR4-2933 ECC /non ECC	DDR4-2933 ECC
	容量	最大128GB (32GB×4)	32GB (16GB×2)
ストレージ	5インチベイ	4	SSD: 512GB×1
	3.5インチシャドールベイ	6	
グラフィックス		インテル® UHD グラフィックス	
I/O	HDMI	1	
	DisplayPort	1	
	DVI-D	1	
	USB	前面 2 (USB3.0, TypeA) / 背面 3 (USB3.2, Gen2, TypeA)、1 (USB3.2, Gen2, TypeC)、2 (USB3.2, Gen1, TypeA)	
	LAN	1 (1GbE)、1 (2.5GbE)	
	Audio	6 (SPDIF-out, Surround-out, CEN/LFE-out, Mic-In, Line-in, Line-out)	
拡張スロット		Slot7: Non Slot6: PCI-Express x16 (Gen 3.0、x16/x8シグナル、CPU側) Slot5: Non Slot4: PCI-Express x16 (Gen 3.0、Non/x8シグナル、CPU側) Slot3: PCI-Express x1 (Gen 3.0、x1シグナル、PCH側) Slot2: PCI-Express x4 (Gen 3.0、x4シグナル、PCH側) Slot1: PCI	
外形寸法		タワー W200mm × D488mm × H430mm (突起物等を除く)	
重量		約13.0kg	
電源		ニブロン電源 400W (連続最大容量) / 570W (ピーク容量)	
利用環境	入力電圧	AC90V~240V	
	温度	10℃~35℃	
	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)	
保管環境	温度	-10℃~55℃	
	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)	

■I/Oポート



■拡張スロット



※画像のI/Oポートや電源は実際と異なります。



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
営業時間:9:00~18:00(土日、祝日、年末年始を除く)

TEL:03-5446-5535 mail:cto_sales@hpc.co.jp

WEBサイト:https://embe.hpc.co.jp/

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。

2022年3月現在の内容です。

第3世代Xeon® スケーラブル・プロセッサを搭載 PCIe Gen 4.0規格の転送速度でCPUにダイレクトアクセス

画像処理・マシンビジョン向け4Uラックマウント型 産業用PC
IPC-C621SPI3-R4

- 第3世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ搭載
- インテル® C621Aチップセット装備
- すべての拡張スロットはCPUとダイレクトアクセスし、PCI-Express Gen 4.0対応
- 10ギガビットイーサネット(10GbE)を2基装備
- メモリアクセスの信頼性を高めるECC対応メモリーを搭載
- 信頼性の高いニプロン電源を搭載
- 長期供給と安定稼働に優れたEmbedded構成



第3世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ

第3世代 Xeon スケーラブル・プロセッサは 10nm 世代の CPU で、前世代と比べてメモリチャンネル数の増加等の特長があります。L1 データキャッシュや L2 キャッシュ、L2 TLB、命令実行ポート数が増強されて IPC が平均 18% 向上し、シングルスレッドのアプリケーション、および、並列数の大きいアプリケーションの両方の高速化に期待の持てる設計となっています。マルチタスクで厳しいワークロードが求められる 24 時間 365 日稼働が想定される装置/システムへの組み込みに適しています。

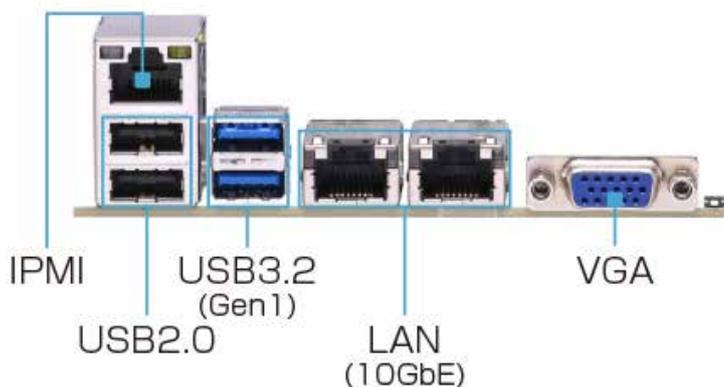
すべての拡張スロットはCPUとダイレクトアクセスし、PCI-Express Gen 4.0対応

IPC-C621SPI3-R4 に装備するすべての拡張スロットは、PCI-Express Gen 4.0 規格の転送速度のままに第3世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサへとダイレクトアクセスします。NVIDIA® Ampere アーキテクチャーの NVIDIA RTX シリーズ / GeForce RTX 30 シリーズ搭載時は GPU 本来のパフォーマンスを発揮することができます。さらに x8 レーン x4 レーンでは高速ストレージなどが搭載可能です。マシンビジョン、ディープラーニング、エッジコンピューティング分野などで求められる高速処理を実現することができます。

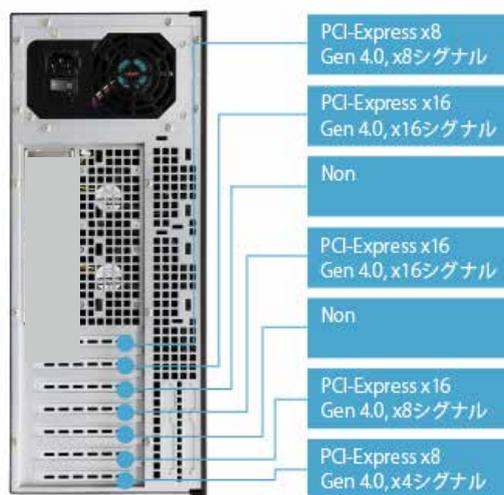
■製品仕様

モデル	IPC-C621SPI3-R4		IPC-C621SPI3-R4 短納期可能モデル
プロセッサ	種類	第3世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ	
	搭載数	1	
チップセット	インテル® C621Aチップセット		
OS	-		Windows10 IoT Enterprise LTSC 2021 64-bit (日本語)
メモリー	規格	DDR4-2933 ECC Reg	
	容量	最大2TB (256GB×8)	32GB (16GB×2)
ストレージ	3.5インチベイ	1	SSD: 512GB×1
	5インチシャドールベイ	1	
グラフィックス	ASPEED AST2600 BMC		
I/O	VGA	1	
	USB	前面 2 (USB2.0) / 背面 2 (USB3.2, Gen1)、2 (USB2.0)	
	LAN	2 (10GbE)	
	IPMI	1	
拡張スロット	Slot7 : PCI-Express x8 (Gen 4.0、x8シグナル、CPU側) Slot6 : PCI-Express x16 (Gen 4.0、x16シグナル、CPU側) Slot5 : Non Slot4 : PCI-Express x16 (Gen 4.0、x16シグナル、CPU側) Slot3 : Non Slot2 : PCI-Express x16 (Gen 4.0、x8シグナル、CPU側) Slot1 : PCI-Express x8 (Gen 4.0、x4シグナル、CPU側)		
外形寸法	4Uラックマウント W429.5mm × D480mm × H177mm (突起物等を除く)		
重量	約20kg		
電源	ニプロン電源 822W (連続最大容量)/1000W (ピーク容量)		
利用環境	入力電圧	AC90V~240V	
	温度	10℃~35℃	
	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)	
保管環境	温度	-10℃~55℃	
	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)	

■I/Oポート



■拡張スロット



※画像のI/Oポートや電源は実際と異なります。



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
営業時間:9:00~18:00(土日、祝日、年末年始を除く)

TEL:03-5446-5535 mail:cto_sales@hpc.co.jp

WEBサイト:https://embe.hpc.co.jp/

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。

2022年3月現在の内容です。